

Title (en)

Nozzle for applying glue

Title (de)

Düsenaggregat zum Auftragen von Leim

Title (fr)

Buse pour l'application de colle

Publication

**EP 0719592 A2 19960703 (DE)**

Application

**EP 95120453 A 19951222**

Priority

- DE 4447016 A 19941230
- US 58209796 A 19960102

Abstract (en)

The applicator dispenses a rapid hardening glue under pressure through a narrow nozzle (31). A water feed duct (32) feeds into the glue duct and applies water under pressure prior to parking the applicator. The outside of the jet is then closed by a closing element (30) to prevent loss of water and glue. The water feed is through the support structure (33) of the applicator. The parking station for the applicator has a reservoir to collect water and glue dripping from the nozzle. Prior to re-use the water can be expelled by a fresh feed of glue.

Abstract (de)

Bei der Verarbeitung von schnell aushärtenden fließfähigen Substanzen, insbesondere Leim, ist es wichtig, ein Aushärten von Leimrückständen innerhalb des Düsenaggregats bei zeitweiliger Betriebsunterbrechung zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird eine Flüssigkeit, insbesondere Wasser, in einen Düsenkanal eingeführt, so daß Leim aus einem einer Düsenmündung (17) zugekehrten Endabschnitt (31) herausgespült wird. Durch Verschuß des Düsenkanals (16) bleibt eine Wassersäule im Düsenkanal (16) und dichtet diesen nach außen ab. <IMAGE>

IPC 1-7

**B05C 11/10**; **B05C 5/02**

IPC 8 full level

**B05B 1/32** (2006.01); **B05B 15/02** (2006.01); **B05B 15/52** (2018.01); **B05B 15/55** (2018.01); **B05C 5/02** (2006.01); **B05C 9/12** (2006.01); **B05C 21/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B05B 15/52** (2018.01 - EP US); **B05B 15/55** (2018.01 - EP US); **B05C 5/02** (2013.01 - EP US); **B05C 9/12** (2013.01 - EP US)

Cited by

DE19814491A1; DE102006051277A1; DE19720066A1; EP2835180A1; EP2835181A1; EP1918097A2; WO2008155117A1; DE102007029064A1; US9080686B2; EP2878382A1; US10183307B2; JP2010531415A

Designated contracting state (EPC)

DE GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0719592 A2 19960703**; **EP 0719592 A3 19970502**; **EP 0719592 B1 20030326**; JP H08252487 A 19961001; US 5915625 A 19990629

DOCDB simple family (application)

**EP 95120453 A 19951222**; JP 8796 A 19960104; US 58209796 A 19960102